

# 2012年3月期 決算会社説明会



# 岡田 博和

〔生年月日〕 1951年8月11日

〔出身地〕 京都府

## 【略歴】

- 1979年 東和精密工業株式会社(現 TOWA株式会社)設立に参画
- 1991年 取締役生産本部副本部長 兼 システム製造部長
- 1995年 取締役 営業本部長
- 1997年 TOWA ASIA-PACIFIC PTE. LTD. Managing Director
- 2004年 TOWA Taiwan LTD. Managing Director
- 2006年 取締役常務執行役員・PM市場開発室長
- 2008年 取締役常務執行役員・開発本部長
- 2010年 専務取締役(営業本部、開発本部、坂東記念研究所担当)
- 2012年 代表取締役社長

## 2012年3月期 ハイライト

- 1、震災・洪水への対応
- 2、収益力と財務体質の改善
- 3、Samsung Electronics とのJV解消
- 4、プライベートショー

## 【 当社グループの被災状況 】

TOWATEC株式会社（サービス事業）

東北サービスの入居ビルが被災 ⇒ 移転

## 【 お客様の被災状況 】

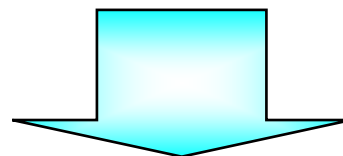
国内半導体メーカーの工場が甚大な被災

サービス部隊を派遣し、工場の再稼動に協力

無償で装置の修理・調整を実施

## 2011年10月 タイで大洪水が発生

世界のHDD生産工場が集まっている地域  
多くの半導体メーカーも被災



● 当社装置の納入工場へ技術者を長期派遣

● 代替設備の短納期手配

⇒ プロジェクト化してTOWAグループ全社で対応

# 2012年3月期 通期(連結)業績

(億円)

	期初計画	通期業績
売上高	190	171
営業利益	13 (6.8%)	15 (8.6%)
経常利益	12	17
当期純利益	11	10


タイの洪水被害への対応が、結果的に特需となり、収益にも大きく貢献することとなった。

関係会社株式売却損  
5.6億円

(単位:億円)

## 直近5年間の有利子負債の推移

2008/3期	2009/3期	2010/3期	2011/3期	2012/3期
119	143	116	77	56



87億円の圧縮

## 直近5年間のDEレシオの推移 (下段=自己資本)

2008/3期	2009/3期	2010/3期	2011/3期	2012/3期
0.73	1.30	1.05	0.52	0.35
163	110	110	147	160



# バランスシートを更にスリム化

米国子会社：TOWA America Corporation

遊休不動産(事務所 兼 工場)を売却

(土地)	23,764m <sup>2</sup>
(建物)	4,422m <sup>2</sup>
(売却額)	US\$4,200,000





# 過去の(連結)業績推移

単位:億円

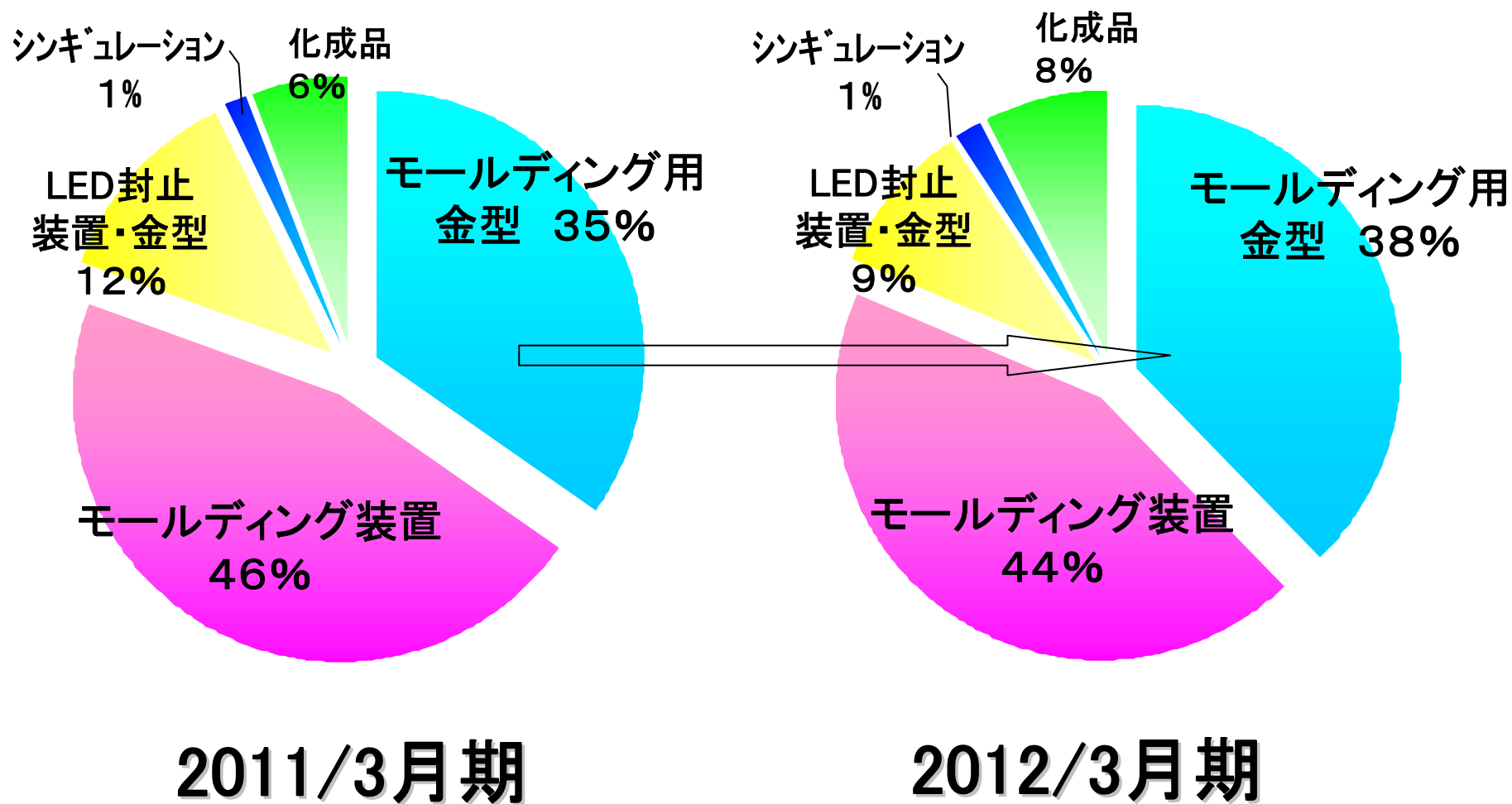
	02/3 期	03/3 期	04/3 期	05/3 期	06/3 期	07/3 期	08/3 期	09/3 期	10/3 期	11/3 期	12/3 期
売上高	136	144	181	241	196	251	257	115	142	225	171
営業利益	-26	-30	4	4	-30	12	23	-33	-3	40	15

'02/3~'10/3期 : 平均売上高 185億円 営業利益▲9億円

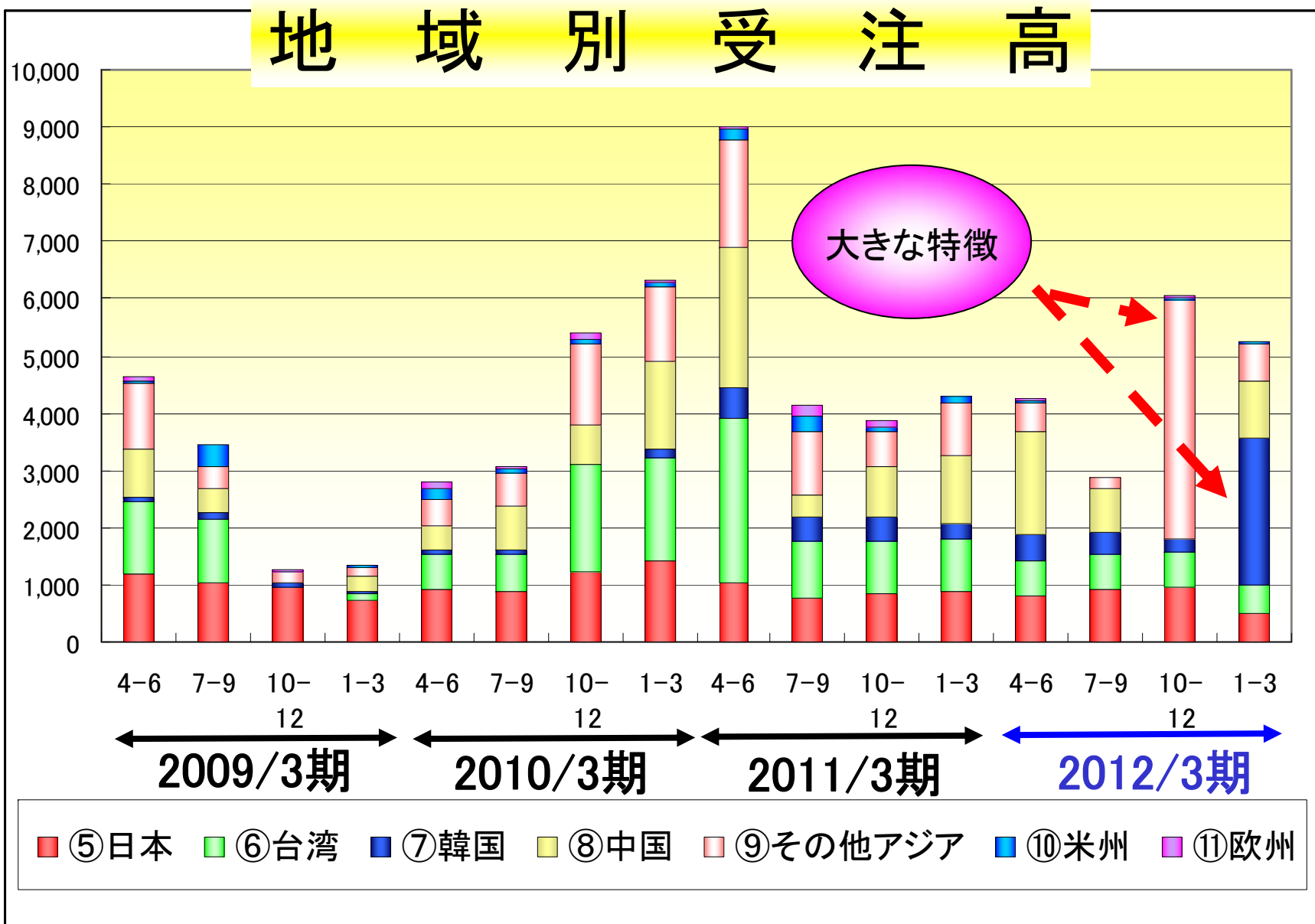
2012/3月期 : 売上高 171億円 営業利益15億円

損益分岐点(営業利益ベース) : 現状=140億円程度(>売上高は過去10年で2回)

# 製品別売上高構成



# 地域別受注高



## SECRON CO.,LTD

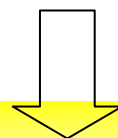
1993年 Samsung Electronics とのJVとして設立  
(半導体製造装置の製造・販売)

Samsung Electronics	50.6%
TOWA株式会社	22.5%



全株売却

8,740百万W



TOWAがSamsung Electronics から直接受注する形態へ

# プライベートショー開催



**TOWA** PRIVATE SHOW 2011

2011年12月7日～12月21日

# TOWA Private Show 2011 New Packaging Solution

**SHINKA**  
Innovation for the Future

**Transfer Molding**

進化 INSIGHT **YPM 1150** Semi



深化 INSIGHT **YPM 1150** Semi



**Compression Molding**

進化 INSIGHT **PMC 1040** Semi



新化 INNOVATION **LCM 1010** LED



**Singulation**

深化 INSIGHT **FMS 3040** Semi LED



## 2013年3月期 計画

- 1、業績および投資・その他数値計画
- 2、重点項目（マーケット・製品戦略など）

# 2013年3月期 業績計画

## 中期経営計画

単位：億円

	2012/3期 実績	2013/3期 計画	2012/3期 計画	2013/3期 計画	2014/3期 計画
売上高	171	180	190	220	250
営業利益	15	18	13	22	30
(同率%)	(8.6%)	(10.0%)	(6.8%)	(10.0%)	(12.0%)
経常利益	17	16	12	21	29
当期利益	10	15	11	20	28



## 研究開発・設備投資・その他計画

単位：百万円

	2012/3期 実績	2013/3期 計画
研究開発費 (対売上比%)	238 (1.4%)	360 (2.5%)
設備投資	1,336	1,450

BPS (@1株純資産)	637円	697円
EPS (@1株当期利益)	38.7円	60.0円

## 配 当 の 状 況

(円. 銭)

	中間	期末	合計
2013年3月期 (計画)	0. 00	10. 00	10. 00
2012年3月期 (実績)	0. 00	5. 00	5. 00

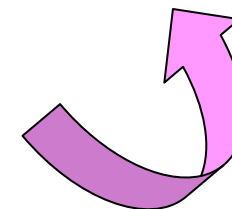
# 1、韓国マーケット

## ●大手IDMとの取引拡大

コンプレッション装置の大量納入  
系列アッセンブリーハウスへ展開



PMC1040-D装置



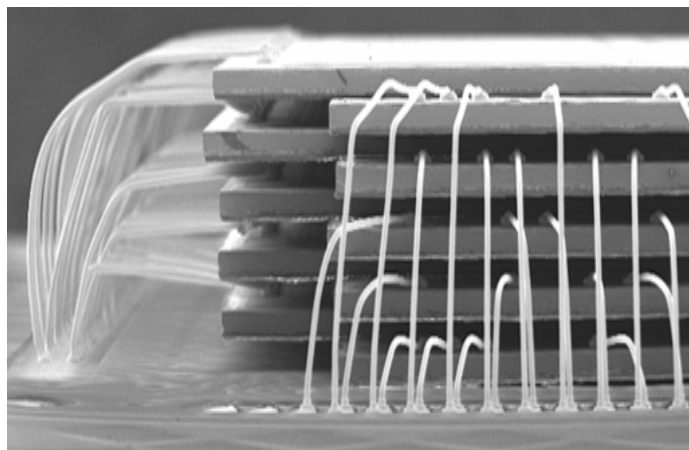
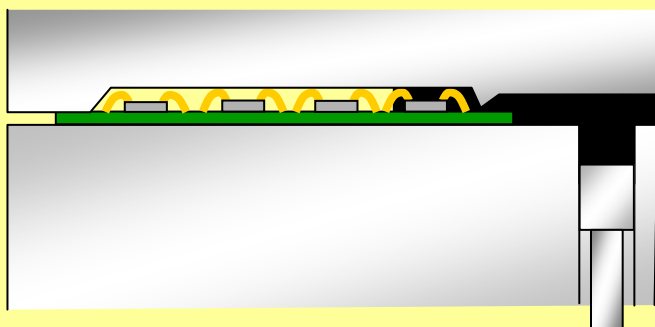
## ●スイッチングのモデルケースに

トランスファー装置 ⇒

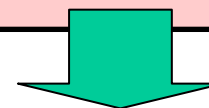
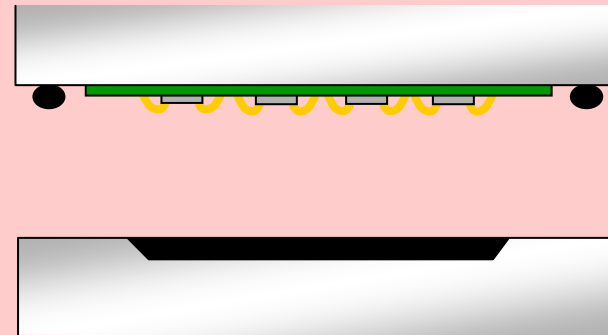
コンプレッション装置

# コンプレッションモールドのメリット

トランスファームールド法



コンプレッションモールド法



樹脂流動が極めて少ない  
金線ワイヤーの細線化が可能

●金線ワイヤー細線化によるコストダウン

$\phi 25 \mu m \Rightarrow \phi 15 \mu m$	約64%の削減
$\phi 22 \mu m \Rightarrow \phi 15 \mu m$	約54%の削減

## 2、北米・欧州マーケット

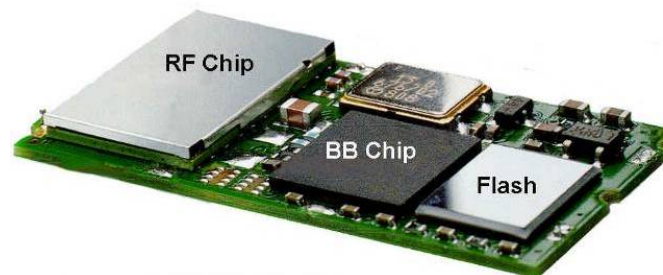
### ● R&D向け営業展開

北米営業拠点に試打プレスを設置  
開発段階のPKG評価を可能に

### ● ファブレス企業へのアプローチ

クアルコム、ブロードコム、マーベル、AMD etc...

### ● 欧州R&Dからロシアまで



### 3、新素材金型の事業化

#### A) 高離型素材

##### ◆ 離型ストレスの低減

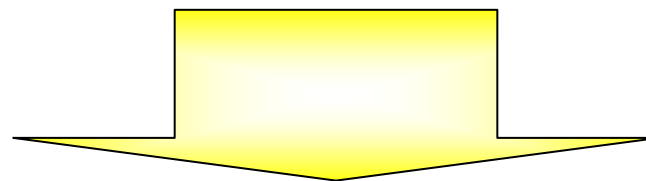
- ・ エジェクター構造が不要(金型構造が簡素化)

##### ◆ クリーニングサイクル(連続生産時間)の伸張

- ・ 画期的に生産性が向上

#### B) 新しい概念の金型へ

##### ◆ 超短納期化へ



事業化に向けて開発中

## 4、ICアッセンブリーハウスのLED参入を捉える

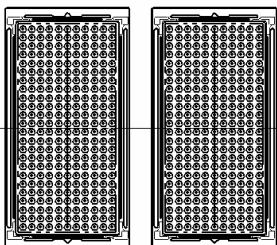
ICアッセンブリーハウス



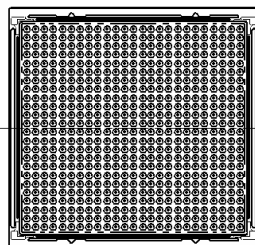
本格的にLEDに参入



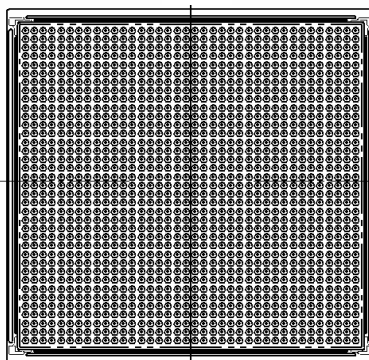
50mmx101mmx 2  
528個



101mmx101mm  
600個



150mmx150mm  
**1,406 個**



LCM1010装置

- ・モジュール方式
- ・□150mm基板対応(セラミック)
- ・自社製2液混合ディスペンサー搭載

## ◆プライベートショー来社先のフォロー

- 来客数65社 約200名

## ◆新製品のコストダウン

- シンギュレーション装置 (FMS3040)
- 海外拠点の活用

## ◆ボリュームゾーンでの戦い

- 150tonプレス装置 (YPM1150)

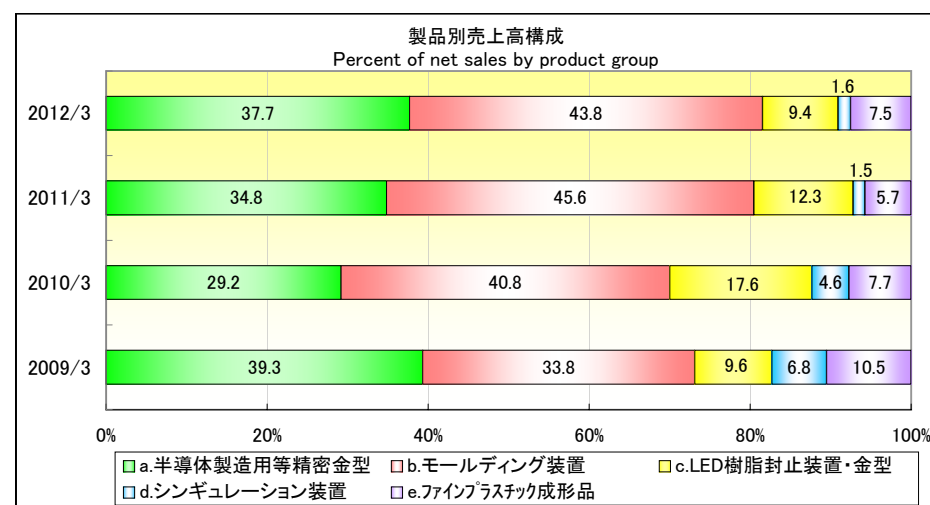
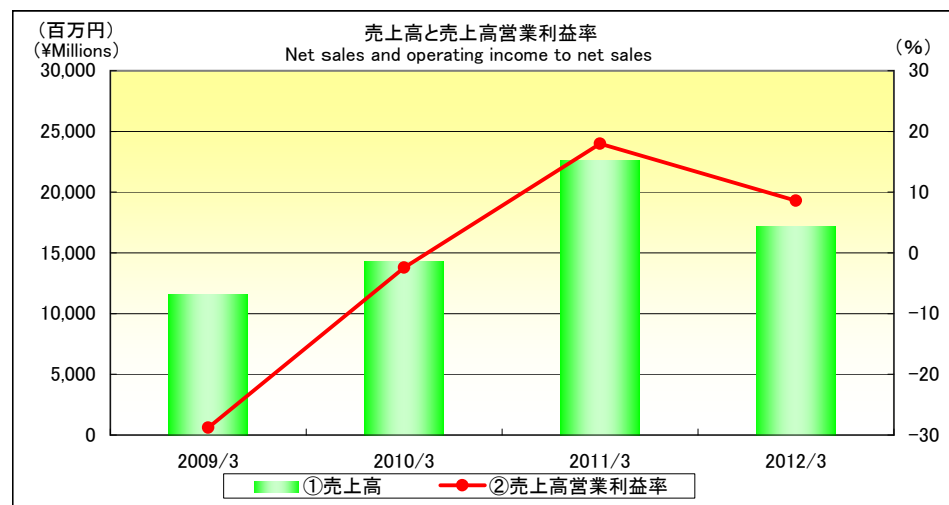
## ◆先端PKG (Flip Chip・TSV・WLP等) への対応



SHINKA  
**TOWA 真価に挑む**

**“Challenge to SHINKA”**  
**Creating value through innovation**

# I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)

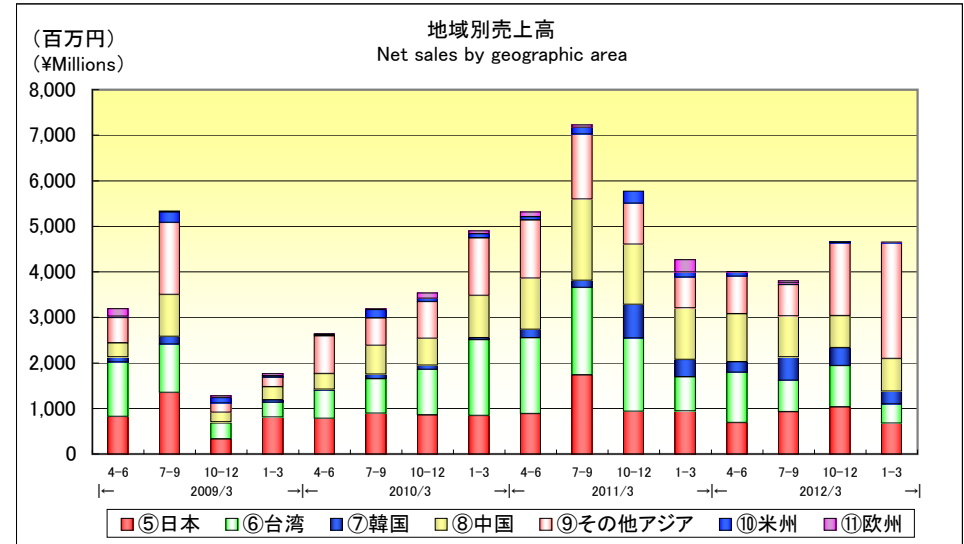
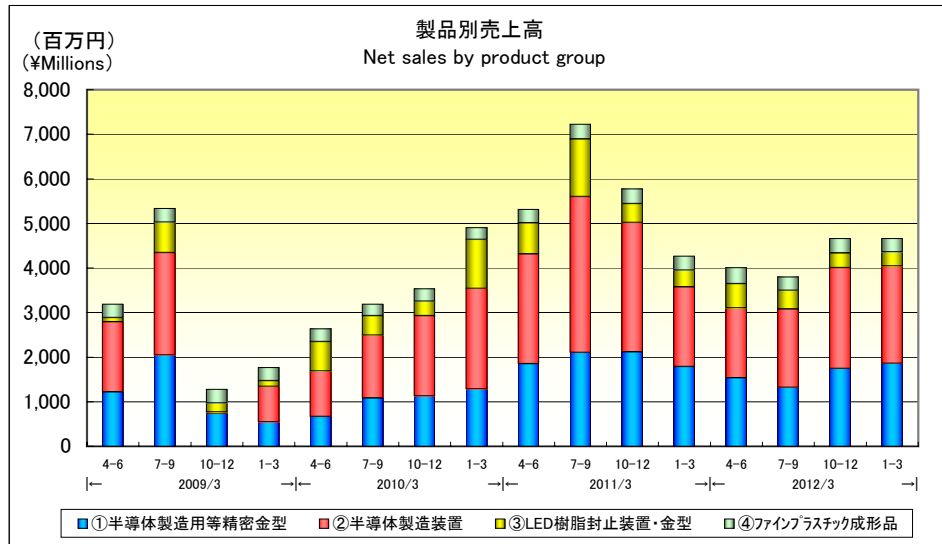


a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED  
d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2011/9
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions				
売上高	11,577	14,274	22,592	17,140	7,813
営業利益	-3,337	-338	4,067	1,476	764
経常利益	-3,677	-345	4,064	1,672	571
当期純利益	-4,163	-330	3,751	968	-36
総資産	27,949	26,738	27,288	26,817	25,637
純資産	11,089	11,091	14,771	15,926	14,531
1株当たり指標	Per share data				
1株当たり当期純利益	-166.45	-13.19	150.00	38.71	-1.44
諸指標	Data				
自己資本当期純利益率	-30.3	-3.0	29.0	6.3	-0.2
総資産経常利益率	-11.8	-1.3	15.0	6.2	2.2
売上高営業利益率	-28.8	-2.4	18.0	8.6	9.8
自己資本比率	39.7	41.5	54.1	59.4	56.7

(単位: 百万円/¥Millions)

II. 四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



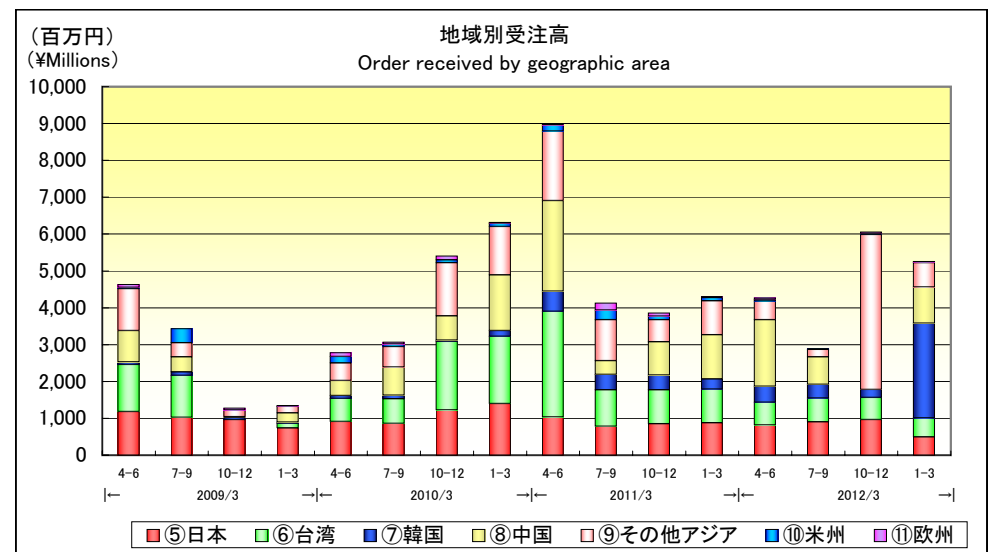
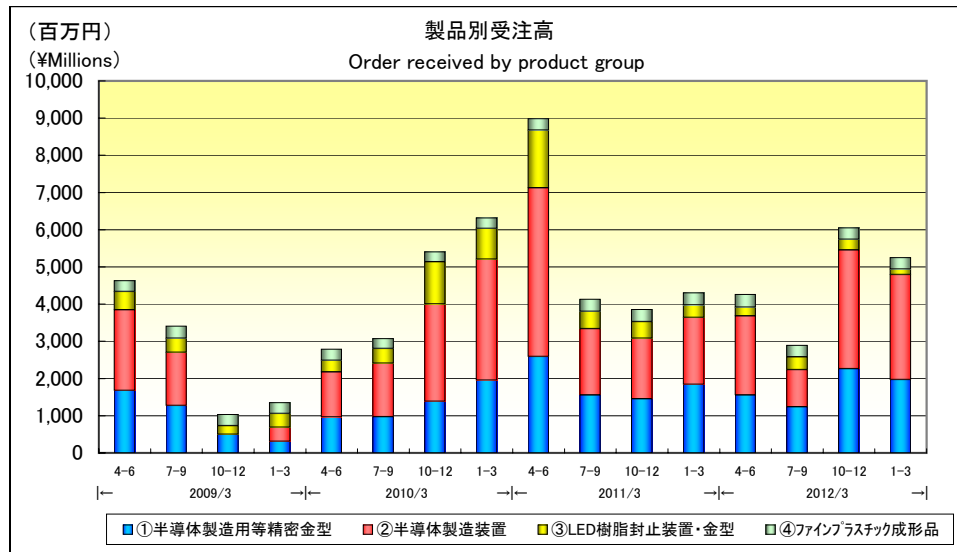
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,218	2,046	739	547	4,552	665	1,086	1,127	1,287	4,167	1,852	2,104	2,121	1,787	7,866	1,537	1,320	1,745	1,859	6,462
半導体製造装置 ②Semiconductor manufacturing equipment	1,575	2,299	29	796	4,700	1,021	1,407	1,801	2,253	6,484	2,462	3,499	2,902	1,786	10,651	1,568	1,761	2,263	2,186	7,780
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	95	681	202	128	1,107	659	435	325	1,100	2,520	698	1,290	420	377	2,786	544	418	333	312	1,608
ファインプラスチック成形品 ④Engineering plastic molded products	302	307	310	295	1,217	293	261	283	263	1,102	304	332	332	319	1,289	359	303	323	301	1,287
月平均	1,064	1,778	428	589	965	880	1,063	1,179	1,635	1,190	1,772	2,409	1,926	1,424	1,883	1,336	1,268	1,555	1,553	1,428

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140
日本 ⑤Japan	820	1,347	329	805	3,302	782	892	856	847	3,379	889	1,735	936	943	4,507	688	925	1,030	675	3,320
アジア太平洋 Asia pacific	2,177	3,740	794	876	7,587	1,811	2,100	2,492	3,900	10,305	4,253	5,290	4,572	2,938	17,060	3,215	2,797	3,605	3,961	13,580
(内 台湾) ⑥Taiwan	1,195	1,067	355	325	2,943	618	763	1,002	1,660	4,044	1,661	1,920	1,611	751	5,945	1,103	695	912	421	3,132
(内 韓国) ⑦Korea	118	166	18	58	362	22	92	92	45	253	187	152	737	380	1,458	237	510	393	282	1,423
(内 中国) ⑧China	309	919	209	287	1,726	341	635	585	926	2,490	1,125	1,786	1,319	1,130	5,363	1,050	903	701	718	3,374
(内 その他アジア) ⑨Other asia	553	1,587	210	204	2,555	829	608	811	1,267	3,516	1,279	1,431	904	675	4,291	823	688	1,598	2,539	5,649
米州 ⑩America	31	226	115	36	409	29	182	74	95	382	70	145	268	117	602	94	32	25	11	164
欧州 ⑪Europe	163	21	44	49	277	17	14	113	62	207	103	55	0	270	423	10	47	4	11	74

Ⅲ. 四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



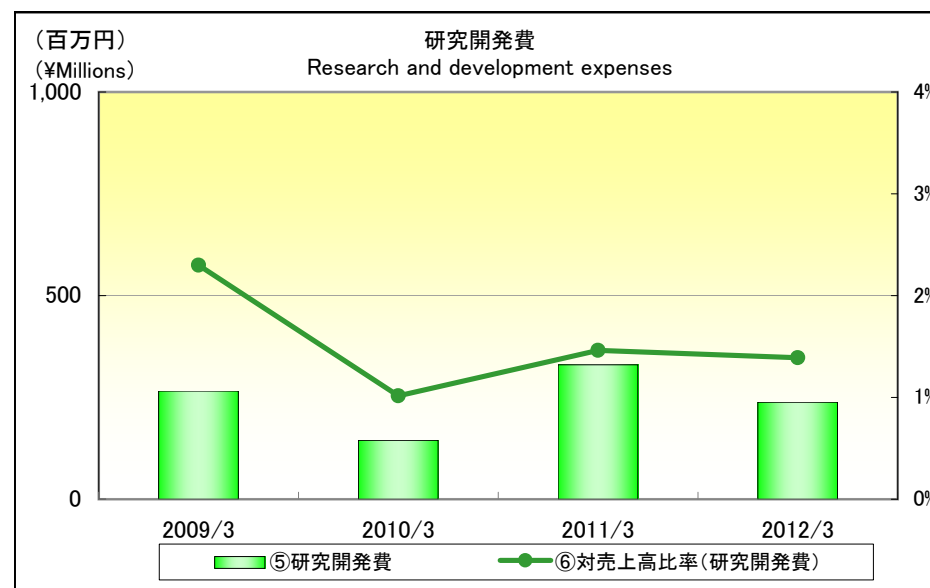
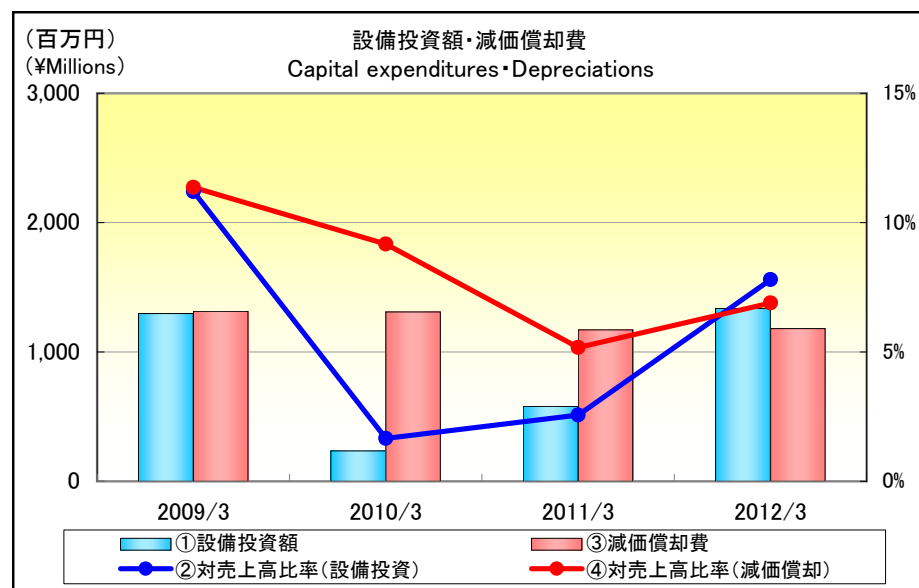
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3					
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	
受注高合計 Total order received	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	
半導体製造用等精密金型	1,679	1,275	498	314	3,767	961	976	1,383	1,951	5,273	2,587	1,554	1,455	1,841	7,438	1,558	1,236	2,263	1,969	7,028	
① Precision molds																					
半導体製造装置	2,166	1,431	-82	376	3,892	1,217	1,433	2,618	3,255	8,524	4,539	1,784	1,622	1,800	9,746	2,128	998	3,191	2,824	9,142	
② Semiconductor manufacturing equipment																					
LED樹脂封止装置・金型	492	376	234	372	1,477	311	395	1,138	827	2,673	1,546	465	454	335	2,801	227	348	289	147	1,013	
③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED																					
ファインプラスチック成形品	296	326	301	288	1,212	295	264	267	282	1,110	316	327	326	327	1,298	350	307	309	313	1,281	
④ Engineering plastic molded products																					
月平均	1,545	1,137	317	450	863	929	1,023	1,802	2,105	1,465	2,996	1,377	1,286	1,435	1,774	1,422	964	2,018	1,752	1,539	

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466
日本 ⑤ Japan	1,178	1,024	966	742	3,911	910	863	1,229	1,400	4,404	1,038	781	853	875	3,548	821	906	963	495	3,187
アジア太平洋 Asia pacific	3,339	2,026	-47	578	5,897	1,590	2,083	3,995	4,801	12,471	7,753	2,893	2,825	3,311	16,783	3,356	1,960	5,016	4,724	15,057
(内 台湾) ⑥ Taiwan	1,277	1,135	-307	118	2,223	627	667	1,858	1,823	4,976	2,863	992	921	913	5,691	615	642	602	512	2,372
(内 韓国) ⑦ Korea	70	100	61	32	266	75	97	31	160	364	546	415	395	277	1,635	435	375	219	2,573	3,604
(内 中国) ⑧ China	854	404	18	254	1,531	415	764	663	1,507	3,351	2,456	376	907	1,198	4,938	1,801	746	-8	981	3,520
(内 その他アジア) ⑨ Other asia	1,136	386	180	172	1,875	471	554	1,442	1,310	3,778	1,886	1,108	601	921	4,518	503	196	4,202	657	5,559
米州 ⑩ America	39	386	-22	7	410	175	74	73	93	417	168	268	95	90	623	44	19	27	25	117
欧州 ⑪ Europe	78	-27	55	23	130	109	48	108	20	287	29	188	84	26	329	43	4	46	9	104

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結)		(単位: 百万円/¥Millions)			
決算期	(Consolidated)	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3
キャッシュフロー	Cash flows				
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	606	2,494	5,571	1,897
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-1,490	-290	-620	-112
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	1,972	-2,733	-3,808	-2,280
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	4,399	3,836	4,933	4,395
設備投資額	①Capital expenditures	1,296	236	578	1,336
対売上高比率	②Ratio of sales	11.19	1.65	2.56	7.79
減価償却費	③Depreciations	1,315	1,309	1,170	1,181
対売上高比率	④Ratio of sales	11.36	9.17	5.18	6.89
研究開発費	⑤Research and development expenses	266	145	330	238
対売上高比率	⑥Ratio of sales	2.30	1.02	1.46	1.39

# この資料に関するお問い合わせ

## TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0270

[http://www.towajapan.co.jp/contact/i\\_ir/index.htm](http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm)

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。